

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60664-4

Deuxième édition  
Second edition  
2005-09

---

---

PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ  
BASIC SAFETY PUBLICATION

---

---

**Coordination de l'isolement des matériels  
dans les systèmes (réseaux) à basse tension –**

**Partie 4:  
Considérations sur les contraintes  
de tension à haute fréquence**

**(standards.iteh.ai)**

**Insulation coordination for equipment  
within low-voltage systems –**

**Part 4:  
Consideration of high-frequency voltage stress**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60664-4:2005

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**  
Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**  
Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:  
Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tél: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee, which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- **Catalogue of IEC publications**  
The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**  
This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**  
If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:  
Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60664-4

Deuxième édition  
Second edition  
2005-09

---

---

PUBLICATION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ  
BASIC SAFETY PUBLICATION

---

---

**Coordination de l'isolement des matériels  
dans les systèmes (réseaux) à basse tension –**

**Partie 4:  
Considérations sur les contraintes  
de tension à haute fréquence**

(standards.iteh.ai)

**Insulation coordination for equipment  
within low-voltage systems –**

**Part 4:  
Consideration of high-frequency voltage stress**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	8
INTRODUCTION.....	12
1 Domaine d'application et objet.....	14
2 Références normatives.....	16
3 Termes et définitions.....	16
4 Distances d'isolement.....	18
4.1 Conditions générales.....	18
4.2 Informations de base.....	18
4.3 Champs homogène et approximativement homogène.....	18
4.4 Champs non homogènes.....	20
5 Lignes de fuite.....	26
5.1 Valeurs expérimentales.....	26
5.2 Dimensionnement des lignes de fuite.....	26
6 Isolation solide.....	32
6.1 Considération générale.....	32
6.2 Facteurs d'influence.....	32
6.3 Dimensionnement de l'isolation solide.....	34
7 Essais à haute fréquence.....	36
7.1 Exigences fondamentales.....	36
7.2 Source de tension d'essai.....	38
7.3 Conditionnement.....	38
7.4 Essai de claquage à haute fréquence.....	38
7.5 Essai de décharges partielles à haute fréquence.....	38
7.6 Exemples des résultats d'essai.....	44
8 Tensions non sinusoïdales.....	44
8.1 Considérations générales.....	44
8.2 Tension de chocs périodique.....	46
8.3 Analyse harmonique.....	46
8.4 Procédure de dimensionnement et essais.....	46
Annexe A (informative) Caractéristiques d'isolement des distances d'isolement sous des tensions à haute fréquence.....	50
Annexe B (informative) Caractéristiques d'isolement des lignes de fuite sous des tensions à haute fréquence.....	64
Annexe C (informative) Caractéristiques d'isolement de l'isolation solide sous des tensions à haute fréquence.....	70
Annexe D (normative) Essais de l'isolation sous des tensions à haute fréquence.....	90
Annexe E (informative) Isolation subissant des contraintes avec des tensions à haute fréquence non sinusoïdales.....	118
Annexe F (informative) Schémas de dimensionnement.....	128
Bibliographie.....	132

## CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	13
1 Scope and object.....	15
2 Normative references .....	17
3 Terms and definitions .....	17
4 Clearances .....	19
4.1 General conditions .....	19
4.2 Basic information.....	19
4.3 Homogeneous and approximately homogeneous fields.....	19
4.4 Inhomogeneous fields .....	21
5 Creepage distances.....	27
5.1 Experimental data .....	27
5.2 Dimensioning of creepage distances .....	27
6 Solid insulation.....	33
6.1 General consideration .....	33
6.2 Influencing factors.....	33
6.3 Dimensioning of solid insulation .....	35
7 High-frequency testing.....	37
7.1 Basic requirements.....	37
7.2 Test voltage source.....	39
7.3 Conditioning .....	39
7.4 High-frequency breakdown test.....	39
7.5 High-frequency partial discharge test.....	39
7.6 Examples of test results .....	45
8 Non sinusoidal voltages.....	45
8.1 General considerations.....	45
8.2 Periodic impulse voltage.....	47
8.3 Harmonic analysis .....	47
8.4 Dimensioning procedure and testing.....	47
 Annex A (informative) Insulation characteristics of clearances at high-frequency voltages.....	 51
Annex B (informative) Insulation characteristics of creepage distances at high-frequency voltages.....	65
Annex C (informative) Insulation characteristics of solid insulation at high-frequency voltages.....	71
Annex D (normative) Testing of insulation at high-frequency voltages.....	91
Annex E (informative) Insulation stressed with non-sinusoidal high-frequency voltages .....	119
Annex F (informative) Dimensioning diagrams .....	129
 Bibliography.....	 133

Figure 1 – Dimensionnement des distances d'isolement dans l'air non homogènes sous pression atmosphérique (électrodes pointe-plan, rayon de 5 $\mu\text{m}$ ), afin d'éviter les DP (distance d'isolement $\geq 1$ mm) ou le claquage (distance d'isolement $< 1$ mm).....	24
Figure 2 – Dimensionnement des lignes de fuite pour éviter les décharges partielles (ligne de fuite $\geq 1$ mm) ou le claquage (ligne de fuite $< 1$ mm) .....	30
Figure 3 – Intensité de champ admissible pour le dimensionnement de l'isolation solide conformément à l'Equation (3) .....	36
Figure 4 – Tension de chocs périodique (voir Partie 1) .....	46
Figure A.1 – Claquage à haute fréquence dans l'air sous pression atmosphérique, champ homogène, gamme de fréquences 50 Hz – 25 MHz [3] .....	52
Figure A.2 – Claquage à haute fréquence dans l'air sous pression atmosphérique, champ homogène, gamme de fréquences 50 Hz – 2,5 MHz [4] .....	54
Figure A.3 – Pointe de l'aiguille après claquage (en haut) et avant claquage (en bas) .....	56
Figure A.4 – Tensions de seuil de DP dans l'air sous pression atmosphérique pour $f = 100$ kHz, électrodes pointe-plan avec un rayon de point différent [6].....	58
Figure A.5 – Tensions d'extinction de DP et tensions de claquage dans l'air sous pression atmosphérique pour $f = 460$ kHz, électrodes pointe-plan avec des aiguilles BB [6].....	60
Figure A.6 – Tensions d'extinction de DP et tensions de claquage dans l'air sous pression atmosphérique pour $f = 1$ MHz, électrodes pointe-plan avec des aiguilles BB [6].....	62
Figure B.1 – Epruvette pour la mesure des tensions de DP et des tensions de tenue des lignes de fuite jusqu'à 6,3 mm .....	64
Figure B.2 – Résultats d'essai de la tension d'extinction de DP $U_e$ des lignes de fuite jusqu'à 6,3 mm [6] .....	68
Figure B.3 – Résultats d'essai de la tension de claquage $U_b$ des lignes de fuite jusqu'à 6,3 mm [6] .....	68
Figure C.1 – Capacité de tenue aux DP des revêtements; tension d'essai constante $U_t$ ( $f = 50$ Hz) [12] .....	72
Figure C.2 – Capacité de tenue aux DP des revêtements; tension d'essai à augmentation linéaire $U_t$ ( $f = 50$ Hz) [12].....	72
Figure C.3 – Claquage à haute fréquence, isolation solide; $d = 0,75$ mm [15].....	78
Figure C.4 – Claquage à haute fréquence, isolation solide, influence de l'humidité; conditionnement à 50 °C; #1: résines phénoliques micacées, $d = 0,75$ mm; #2: stratifiés silicone-verre, $d = 1,5$ mm [19] .....	80
Figure C.5 – Claquage à haute fréquence, films isolants; #1: Cellulose-Acétobutyrate, #2: Polycarbonate; #3: Cellulose-Triacétate [20] .....	84
Figure C.6 – Claquage à haute fréquence, films isolants; #1: Polystyrène, $d = 80$ $\mu\text{m}$ , #2: Polyéthylène, $d = 50$ $\mu\text{m}$ [20].....	88
Figure D.1 – Transformateur à résonance à haute fréquence; influence du nombre de spires de la bobine secondaire $N_2$ sur la tension de sortie $U_2$ ; $N_1 = 20$ ; $N_2 = 210/280/350/420/560$ [22].....	90
Figure D.2 – Oscillateur à puissance élevée et à haute fréquence [5] et [6] .....	92
Figure D.3 – Circuit d'essai de DP pour les essais de tension à haute fréquence [22].....	96
Figure D.4 – Schéma du circuit d'essai [5] et [6] .....	98
Figure D.5 – Réponse d'impulsion de DP pour une fréquence d'impulsion de DP considérée de 2 MHz pour différentes fréquences de coupure supérieures $f_c$ du circuit d'essai; cela inclut un filtre coupe-bande de 3 <sup>ème</sup> ordre avec $f_{\text{centre}} = 1$ MHz [5] et [6] .....	100
Figure D.6 – Circuit équivalent d'un circuit d'essai de DP avec des constantes discrètes [5].....	104

Figure 1 – Dimensioning of inhomogeneous clearances in air at atmospheric pressure (point-plane-electrodes, 5 $\mu\text{m}$ radius) to avoid PD (clearance $\geq 1$ mm) or breakdown (clearance $< 1$ mm) .....	25
Figure 2 – Dimensioning of creepage distances to avoid partial discharge (creepage distance $\geq 1$ mm) or breakdown (creepage distance $< 1$ mm) .....	31
Figure 3 – Permissible field strength for dimensioning of solid insulation according to Equation (3) .....	37
Figure 4 – Periodic impulse voltage (see Part 1) .....	47
Figure A.1 – Breakdown at high frequency in air at atmospheric pressure, homogeneous field, frequency range 50 Hz – 25 MHz [3] .....	53
Figure A.2 – Breakdown at high frequency in air at atmospheric pressure, homogeneous field, frequency range 50 Hz – 2,5 MHz [4] .....	55
Figure A.3 – Needle tip after (upper) and before (lower) breakdown .....	57
Figure A.4 – PD inception voltages in air at atmospheric pressure for $f = 100$ kHz, point-plane electrodes with different point radius [6] .....	59
Figure A.5 – PD extinction voltages and breakdown voltages in air at atmospheric pressure for $f = 460$ kHz, point-plane electrodes with BB-needles [6] .....	61
Figure A.6 – PD extinction voltages and breakdown voltages in air at atmospheric pressure for $f = 1$ MHz, point-plane electrodes with BB-needles [6] .....	63
Figure B.1 – Test specimen for measuring the PD voltages and the withstand voltages of creepage distances up to 6,3 mm .....	65
Figure B.2 – Test results of the PD extinction voltage $U_e$ of creepage distances up to 6,3 mm [6] .....	69
Figure B.3 – Test results of the breakdown voltage $U_b$ of creepage distances up to 6,3 mm [6] .....	69
Figure C.1 – PD withstand capability of coatings; constant test voltage $U_t$ ( $f = 50$ Hz) [12] 73	73
Figure C.2 – PD withstand capability of coatings; linearly increasing test voltage $U_t$ ( $f = 50$ Hz) [12] .....	73
Figure C.3 – Breakdown at high frequency, solid insulation; $d = 0,75$ mm [15] .....	79
Figure C.4 – Breakdown at high frequency, solid insulation, influence of humidity; conditioning at 50 °C; #1: mica-filled phenolic, $d = 0,75$ mm; #2: glass-silicone laminate, $d = 1,5$ mm [19] .....	81
Figure C.5 – Breakdown at high frequency, insulating films; #1: Cellulose-Acetobutyrate, #2: Polycarbonate; #3: Cellulose-Triacetate [20] .....	85
Figure C.6 – Breakdown at high frequency, insulating films; #1: Polystyrene, $d = 80$ $\mu\text{m}$ , #2: Polyethylene, $d = 50$ $\mu\text{m}$ [20] .....	89
Figure D.1 – High-frequency resonance transformer; influence of the number of turns of the secondary coil $N_2$ on the output voltage $U_2$ ; $N_1 = 20$ ; $N_2 = 210/280/350/420/560$ [22] 91	91
Figure D.2 – High-frequency high power oscillator [5] and [6] .....	93
Figure D.3 – PD test circuit for high-frequency voltage tests [22] .....	97
Figure D.4 – Diagram of the test circuit [5] and [6] .....	99
Figure D.5 – PD impulse response for an assumed PD impulse frequency of 2 MHz for different upper cut-off frequencies $f_c$ of the test circuit; this includes a 3 <sup>rd</sup> order band-stop filter with $f_{\text{centre}} = 1$ MHz [5] and [6] .....	101
Figure D.6 – Equivalent circuit of a PD test circuit with lumped elements [5] .....	105
Figure D.7 – Transfer characteristics of PD test circuits when using a PD-impulse voltage source versus a PD impulse current source [5] .....	107

Figure D.7 – Caractéristiques de transfert des circuits d’essai de DP en utilisant une source de tension de chocs de DP par rapport à une source de courant de choc de DP [5] .....	106
Figure D.8 – Signal d’entrée $U_{in}$ et signal de mesure $U_m$ en fonction de la capacité du condensateur de couplage $C_K$ (capacité de l’éprouvette $C_3 = 10$ pF) [5] .....	110
Figure D.9 – Essais de DP des optocoupleurs sous une tension à haute fréquence [30] .....	112
Figure D.10 – Essais de DP des transformateurs d’impulsion; influence de la fréquence de la tension [30] .....	114
Figure D.11 – Essais de DP des circuits imprimés revêtus; $U_i, d = 0,2$ mm [30] .....	114
Figure D.12 – Durée de vie $t$ des fils émaillés (paire torsadée) sous une tension à haute fréquence; la contrainte est de 10 % au-dessus de la tension de seuil de DP [31].....	116
Figure E.1 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire .....	120
Figure E.2 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire, spectre .....	120
Figure E.3 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire avec claquage (voir Figure 4) .....	122
Figure E.4 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire avec claquage, spectre .....	122
Figure E.5 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire avec oscillation (1 MHz) .....	124
Figure E.6 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire avec oscillation (1 MHz), spectre .....	124
Figure E.7 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire avec claquage élevé .....	126
Figure E.8 – Tension de chocs périodique, forme d’onde rectangulaire avec claquage élevé, spectre .....	126
Figure F.1 – Schéma pour le dimensionnement des distances d’isolement.....	128
Figure F.2 – Schéma pour le dimensionnement des lignes de fuite .....	130
Tableau 1 – Valeurs minimales des distances d’isolement dans l’air sous pression atmosphérique pour des conditions de champ non homogène.....	26
Tableau 2 – Valeurs minimales des lignes de fuite $d$ pour différentes gammes de fréquences.....	32
Tableau B.1 – Matériaux inclus dans les recherches.....	66
Tableau D.1 – Données de la source de tension d’essai [5] et [6] .....	92

STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

IEC 60664-4:2005

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/218e9623-c930-471d-837b-380c7fd49b3f/iec-60664-4-2005>



Figure D.8 – Input signal $U_{in}$ and measuring signal $U_m$ depending upon the capacitance of the coupling capacitor $C_k$ (capacitance of the test specimen $C_3 = 10$ pF) [5].....	111
Figure D.9 – PD testing of optocouplers at high-frequency voltage [30].....	113
Figure D.10 – PD testing of impulse transformers; influence of the frequency of the voltage [30].....	115
Figure D.11 – PD testing of coated printed circuit boards; $U_i$ , $d = 0,2$ mm [30].....	115
Figure D.12 – Lifetime $t$ of enamelled wires (twisted pair) at high-frequency voltage; stress is 10 % above the PD inception voltage [31].....	117
Figure E.1 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape.....	121
Figure E.2 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape, spectrum.....	121
Figure E.3 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape with overshoot (see Figure 4).....	123
Figure E.4 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape with overshoot, spectrum.....	123
Figure E.5 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape with ringing (1 MHz).....	125
Figure E.6 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape with ringing (1 MHz), spectrum.....	125
Figure E.7 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape with high overshoot.....	127
Figure E.8 – Periodic impulse voltage, rectangular waveshape with high overshoot, spectrum.....	127
Figure F.1 – Diagram for dimensioning of clearances.....	129
Figure F.2 – Diagram for dimensioning of creepage distances.....	131
<a href="https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/218e9623-c930-471d-887b-380c7fd49b3f/iec-60664-4-2005">IEC 60664-4:2005</a>	
Table 1 – Minimum values of clearances in air at atmospheric pressure for inhomogeneous field conditions.....	27
Table 2 – Minimum values of creepage distances $d$ for different frequency ranges.....	33
Table B.1 – Materials included in the investigations.....	67
Table D.1 – Data of the test voltage source [5] and [6].....	93

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

### COORDINATION DE L'ISOLEMENT DES MATÉRIELS DANS LES SYSTÈMES (RÉSEAUX) À BASSE TENSION –

#### Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à haute fréquence

##### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60664-4 a été établie par le comité d'études 109 de la CEI: Coordination de l'isolement pour le matériel à basse tension.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue comme rapport technique en 1997. Elle constitue une révision technique qui conduit au statut de Norme internationale.

Les modifications majeures effectuées au cours de la révision de la CEI 60664-4 ont été les suivantes:

- inclusion d'informations plus récentes concernant les caractéristiques de tenue de l'isolation à des contraintes de tension à haute fréquence (voir Annexes A, B et C);

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT  
WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS –****Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60664-4 has been prepared by IEC technical committee 109: Insulation co-ordination for low-voltage equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition which was issued as a technical report in 1997. It constitutes a technical revision and now has the status of an International Standard.

The major changes made during the revision of IEC 60664-4 were the following:

- inclusion of more recent information about the withstand characteristics of insulation at high-frequency voltage stress (see Annexes A, B and C);

- inclusion d'exigences pour le dimensionnement des distances d'isolement à des contraintes de tension à haute fréquence (voir Article 4);
- inclusion d'exigences pour le dimensionnement des lignes de fuite à des contraintes de tension à haute fréquence (voir Article 5);
- inclusion d'exigences pour le dimensionnement de l'isolation solide à des contraintes de tension à haute fréquence (voir Article 6);
- inclusion de schémas pour fournir des lignes directrices sur le dimensionnement en tenant compte des contraintes de tension à haute fréquence (voir Annexe F);
- spécification d'essais en tenant compte des contraintes de tension à haute fréquence (voir Article 7) ;
- inclusion de circuits d'essai pour les essais de tension de tenue à haute fréquence et les essais de décharges partielles (voir Annexes D.1 et D.2.1);
- inclusion de critères de conception pour les circuits d'essai de décharges partielles sous des tensions à haute fréquence (voir Annexe D.2.2);
- inclusion de critères pour couvrir les contraintes de tension non sinusoïdale (voir Article 8 et Annexe E).

Elle a le statut de publication fondamentale de sécurité, conformément au Guide CEI 104.

La présente Norme internationale doit être utilisée conjointement avec la CEI 60664-1 ou la CEI 60664-5.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
109/51/FDIS	109/53/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60664 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension*:

- Partie 1: Principes, prescriptions et essais
- Partie 2: Guide d'application
- Partie 3: Utilisation de revêtement, d'emportage ou de moulage pour la protection contre la pollution
- Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à haute fréquence
- Partie 5: Méthode détaillée de détermination des distances d'isolement dans l'air et des lignes de fuite inférieures ou égales à 2 mm

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

- inclusion of requirements for the dimensioning of clearances at high-frequency voltage stress (see Clause 4);
- inclusion of requirements for the dimensioning of creepage distances at high-frequency voltage stress (see Clause 5);
- inclusion of requirements for the dimensioning of solid insulation at high-frequency voltage stress (see Clause 6);
- inclusion of diagrams to provide guidance on dimensioning with respect to high-frequency voltage stress (see Annex F);
- specification of tests with respect to high-frequency voltage stress (see Clause 7).
- inclusion of test circuits for high-frequency voltage withstand testing and partial discharge testing (see Annex D.1 and D.2.1);
- inclusion of design criteria for partial discharge test circuits at high-frequency voltage (see Annex D.2.2);
- Inclusion of criteria for dealing with non sinusoidal voltage stress (see Clause 8 and Annex E).

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

This International Standard is to be used in conjunction with IEC 60664-1 or IEC 60664-5.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
109/51/FDIS	109/53/RVD

(standards.iteh.ai)

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

[IEC 60664-4:2005](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/218e9623-c930-471d-837b-5867d9351ec/iec-60664-4-2005>

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60664 consists of the following parts under the general title *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems*:

- Part 1: Principles, requirements and tests
- Part 2: Application guide
- Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
- Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress
- Part 5: A comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

Des contraintes électriques élevées apparaissent également dans les matériels à basse tension. La fréquence est généralement de 50/60 Hz mais, dans certaines applications, des fréquences légèrement plus élevées (400 Hz) ou plus basses ( $16\frac{2}{3}$  Hz,) ou continues peuvent apparaître. Une situation particulière apparaît dans les transmetteurs de radiofréquences de haute puissance. Le développement de tels matériels a été à l'origine de la motivation de recherches sur la capacité de tenue de l'isolation pour les radiofréquences. Depuis ce temps, l'aspect des contraintes de tension à haute fréquence n'a pas été étudié avec beaucoup d'efforts.

Actuellement, les tensions de fonctionnement à haute fréquence dépassant 30 kHz sont souvent utilisées dans des matériels à basse tension, et l'utilisation de fréquences dans le domaine du MHz est probable dans le futur. De nombreuses formes de tension sont non sinusoïdales. Des petites dimensions sont nécessaires pour la miniaturisation et pour une fiabilité élevée, par exemple pour les transformateurs HF. Par conséquent, des contraintes très élevées sont communes pour l'isolation solide.

En augmentant la fréquence, l'effet de détérioration des décharges partielles est également augmenté de façon approximativement proportionnelle à la fréquence, de telle sorte que l'impact des décharges partielles sur le dimensionnement est bien supérieur à la fréquence industrielle.

Comme les distances sont appelées à diminuer et les fréquences à augmenter dans la même période, la situation s'aggravera dans le futur. C'est pourquoi, en tenant compte de la sécurité du personnel et de la fiabilité du matériel, les contraintes dues aux hautes fréquences jusqu'à 100 MHz sont à considérer dans la coordination de l'isolement des matériels à basse tension (voir la note 2 du Domaine d'application de la Partie 1).

[IEC 60664-4:2005](#)

La présente norme résume les données disponibles les plus importantes concernant les contraintes à haute fréquence sur l'isolement et précise comment les matériaux et leurs dimensions sont influencés. Les données pour le dimensionnement des distances d'isolement, des lignes de fuite et de l'isolation solide sont spécifiées. La présente norme décrit aussi la manière dont les essais peuvent être réalisés en tenant compte de ces contraintes.

## INTRODUCTION

High electrical stress also occurs in low-voltage equipment. The frequency is usually 50/60 Hz, but in some applications a higher frequency (400 Hz) or a lower frequency (16 2/3 Hz) or d.c. can occur. A particular situation exists in high-power RF transmitters. The development of such equipment had motivated earlier research on the withstand capability of insulation at radio frequencies. Since that time, the aspect of high-frequency voltage stress had not been pursued with much effort.

At present, high-frequency working voltages exceeding 30 kV are often used in low-voltage equipment, and the use of frequencies in the MHz range is likely in the future. Many of the voltage shapes are non sinusoidal. Small dimensions are necessary for miniaturization and for high efficiency, for instance in high-frequency transformers. Consequently, very high stresses are common in solid insulation.

By increasing the frequency the deteriorating effect of partial discharges is also increased roughly proportionally to the frequency, so that the impact of partial discharges on dimensioning is much higher compared to power frequency.

As dimensions are likely to decrease further and frequencies increase, this situation will be aggravated in the future. Therefore, with respect to safety of personnel and reliability of equipment, the stress due to high frequencies up to 100 MHz has to be considered for insulation coordination of low-voltage equipment, (see note 2 in the Scope of Part 1).

This standard summarizes the most important available data concerning high-frequency stress of insulation, and identifies how materials and their dimensioning are influenced. Data for dimensioning of clearances, creepage distances and solid insulation are specified. This standard also describes how tests can be performed with respect to this stress.

[IEC 60664-4:2005](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/218e9623-c930-471d-837b-380c7fd49b3f/iec-60664-4-2005)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/218e9623-c930-471d-837b-380c7fd49b3f/iec-60664-4-2005>